

亞洲電材股份有限公司 (4939)

2024年第三季法人說明會

2024/11/08

免責聲明

本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、未來擴張計劃及公司策略等訊息。此前瞻性陳述係基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，儘管本公司認為該期望和預測具合理性，但此類前瞻性聲明仍涉及風險及不確定性。鑑於這些風險、不確定性及假設，前瞻性事件可能不會發生，且本公司實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異。若因未來實際結果與預期狀況有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司將不承擔此責任。

大綱(Agenda)

公司概況

AEM Overview

競爭利基

Competitiveness

財務報告

Financial
Results

未來展望

Future Outlook

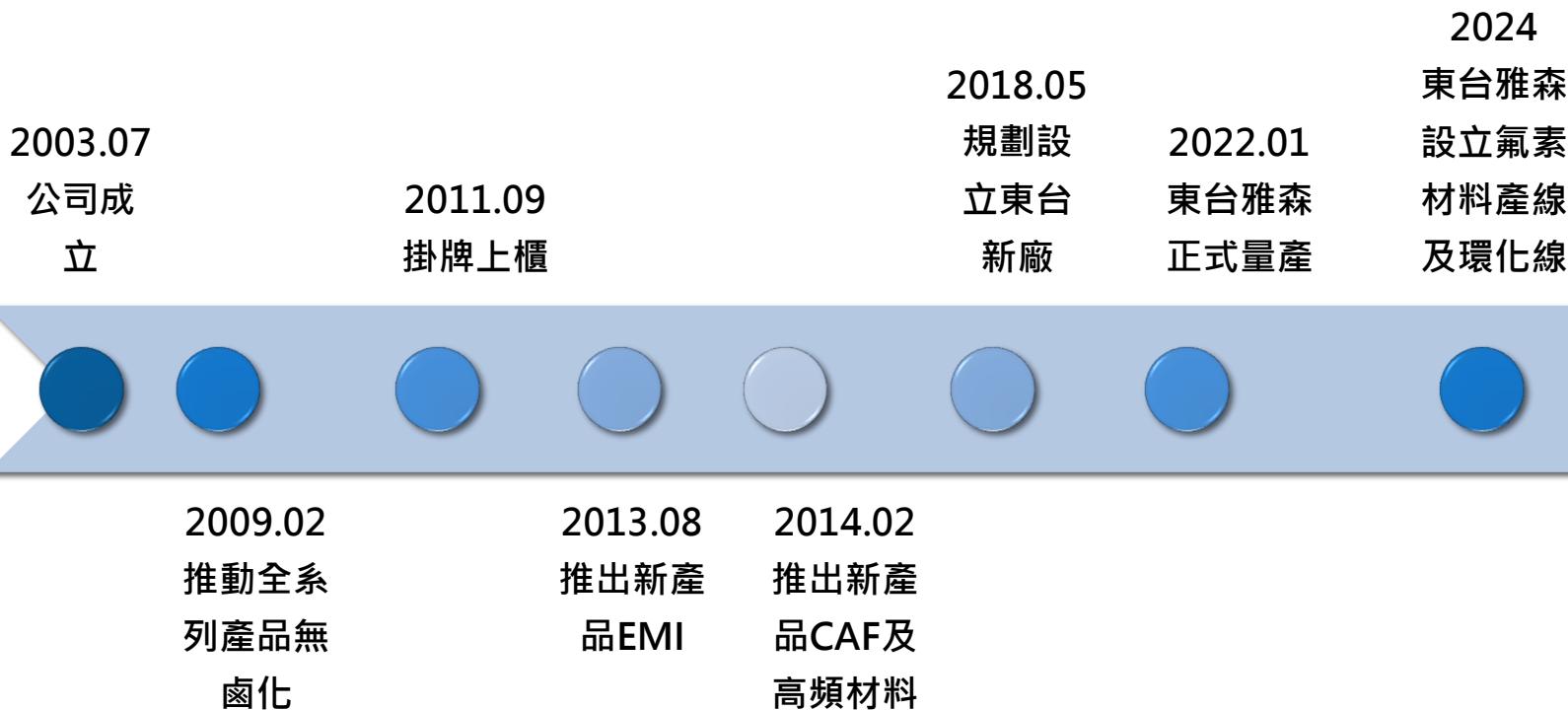
公司概況(AEM Overview)

基本資料

- 成立時間：2003
- 營運總部：新竹縣竹北市
- 生產據點：昆山、東台
- 上櫃日期：2011.09
- 董事長兼總經理：李建輝
- 全球員工數：246名(截至2024/9/30)



公司沿革



經營據點





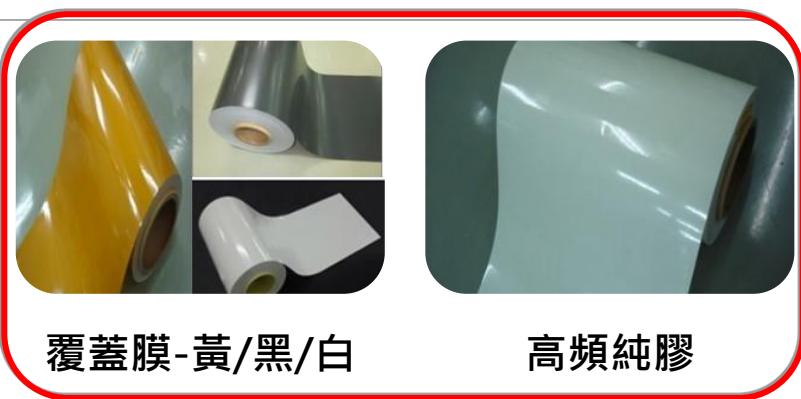
主要產品



3Layer-S/D



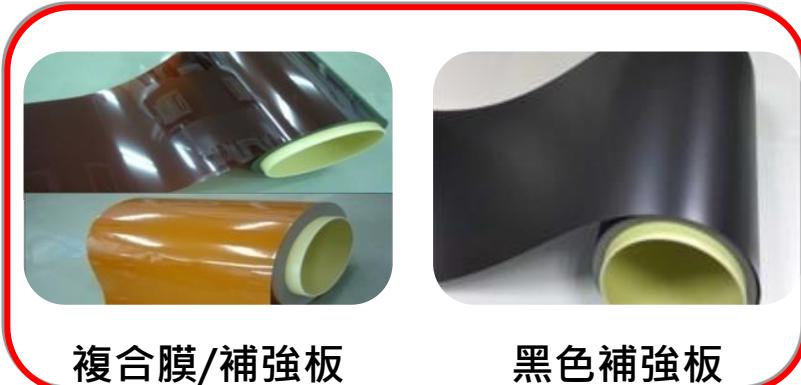
2Layer-S/D



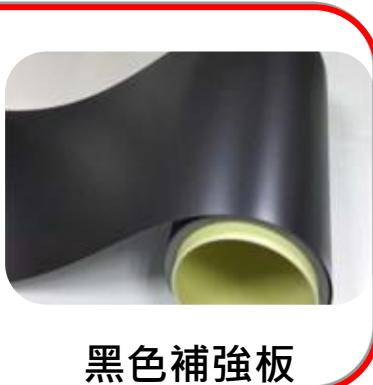
覆蓋膜-黃/黑/白



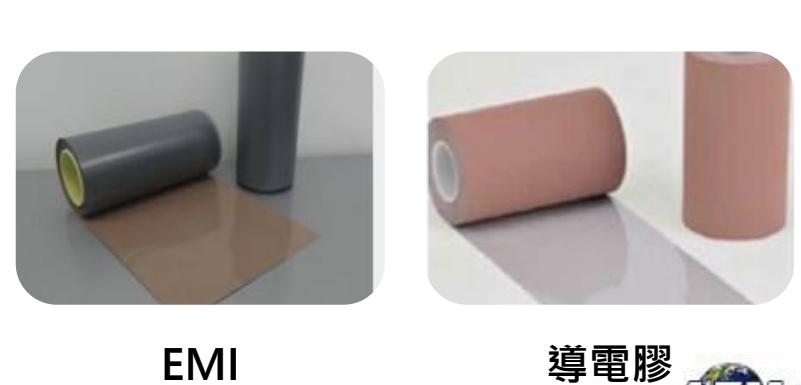
高頻純膠



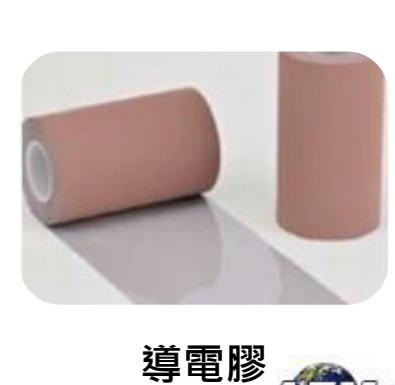
複合膜/補強板



黑色補強板

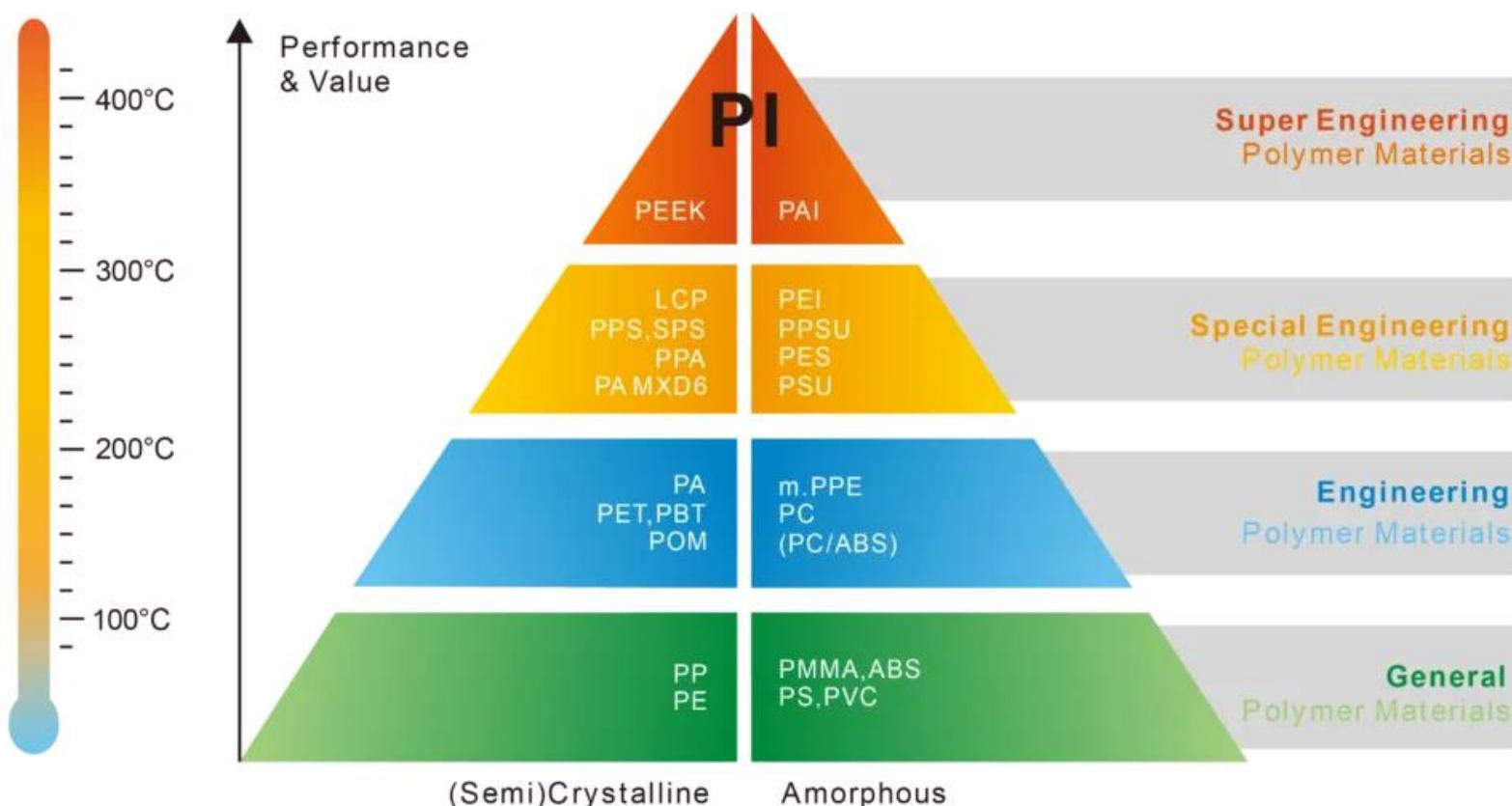


EMI



導電膠

PI性能處於高分子材料金字塔頂端



產品發展歷程-純膠

環氧樹脂
AFEB系列
(有鹵)

2008

MPI-
HFBS

環氧樹脂
AHEB系列
(無鹵)

2010

壓克力-700

2011

MPI-TFBS

MPI-EFBS-K
MPI-EFBS-A-UV
EFBS-K3

2019

純膠開案

- 自研防水設計低吸水率
- 優異的耐高溫高濕性
- 優異的耐蒸煮測試性能
- 優異的儲存性
- 低傳輸損耗特性
(Dk:2.60/2.90,
- Df:0.002)
- 卓越的離子遷移特性
- 良好的可操作性

產品發展歷程-電磁波屏蔽膜

ESF2100

ESF1600/1800

ESF2300/2600/6000P

ESF2400/2500A/
2800/3002P/3003P

2007

2010

2014~2015

2020~2023

2024

投入開發
EMI film
及導電膠
技術

- 工研院材料所
EMI材料技術
團隊入職
- 取得第一篇
EMI專利
- 2012年取得PI
型EMI專利

➤ 自主專利開發
➤ 油墨型EMI

- PI型EMI自主技術
- 遮罩效能
60dB/70dB/>80dB
- 耐彎折、高硬度
(3~4H)
- 耐磨、高可靠度
- 高段差、5G、超高
頻應用

- PI型EMI自主技術
- 多样化的屏蔽效能需求
- 超薄化設計
- 耐彎折、高硬度
- 高段差、超高頻應用
- 針對當前市場需求開發

產品發展歷程-導電膠

CAF200

CAF300

CAF300T

2012

2014

2017~2018

2021~2024

導電膠開案

- 自主專利技術開發
- 導通性 $\leq 1\Omega$
($\varphi \geq 0.1\text{mm}$)
- 優異儲存性
- 高剝離強度

- 自主專利技術開發
- 導通性 $\leq 1\Omega$
($\varphi \geq 0.6\text{mm}$)
- 優異的儲存性
- 優異的可靠度
- 高剝離強度

- 自主專利技術開發
- 導通性 $\leq 1\Omega$
($\varphi \geq 0.4\text{mm}$)
- 高信賴性
- 優異的儲存性
- 優異的可靠度
- 高剝離強度

產品發展歷程-自製PI覆蓋膜

ML3010/3015

2017

覆蓋膜開案

HPB

2019~2023

- 自製PI超薄設計
- 極佳的尺寸安定性
- 自主粗糙度设计
- 優異的操作性
- 出色的耐堿性能
- 優異的填充性

HPBM

2021~2024

- 自製PI設計可做到3μm
- 尺寸安定性 $\leq \pm 0.02\%$
- 自主粗糙度设计
- 優異的操作性
- 出色的耐堿性能
- PI+MPI低吸濕性能
- 優異的填充性
- 儲存壽命長
- 滿足超細線路耐離子遷移

專利布局

類別	已取得	申請中	合計
覆蓋膜	76	17	93
補強版	24	12	36
銅箔基板	140	13	153
膠膜	7	0	7
電磁波屏蔽膜	37	12	49
導電膠	18	3	21
其他	50	0	50
合計	352	57	409

產品應用



電腦及周邊



平板



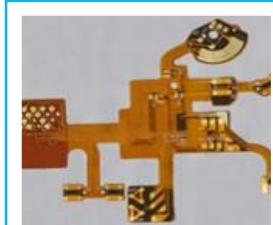
穿戴裝置



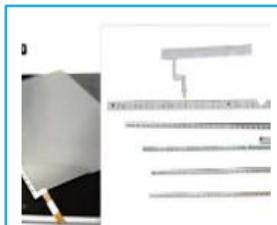
顯示器模組



智慧手機



醫療相關



燈條



車載



機器人

歷年股利配發

股利所屬年度	每股盈餘(元)	現金股利(元/股)	配發率(%)
2017	1.21	0.50	41%
2018	1.14	0.50	44%
2019	0.36	0.25	69%
2020	1.61	1.25	78%
2021	1.76	1.40	80%
2022	0.35	0.48	137%
2023	0.37	0.50	135%

競爭利基(Competitiveness)

專業的團隊/專利佈局

- 具有FPC專業製造的業務及客服團隊
- 經驗與素質優良的製造及研發團隊
- 貼近市場且高效率的產品研發機制

品牌規模優勢/管道策略

- 差異化競爭路線，繼續擴大產品種類
- 與供方維良好合作關係，採購價格具競爭力

精緻化的設備及管理

- 連續式R 2 R自動化製造設備
- 即時線上參數自動監測回饋系統
- 線上CCD外觀檢查&膜厚監控系統
- 可追溯Barcode的物流管理

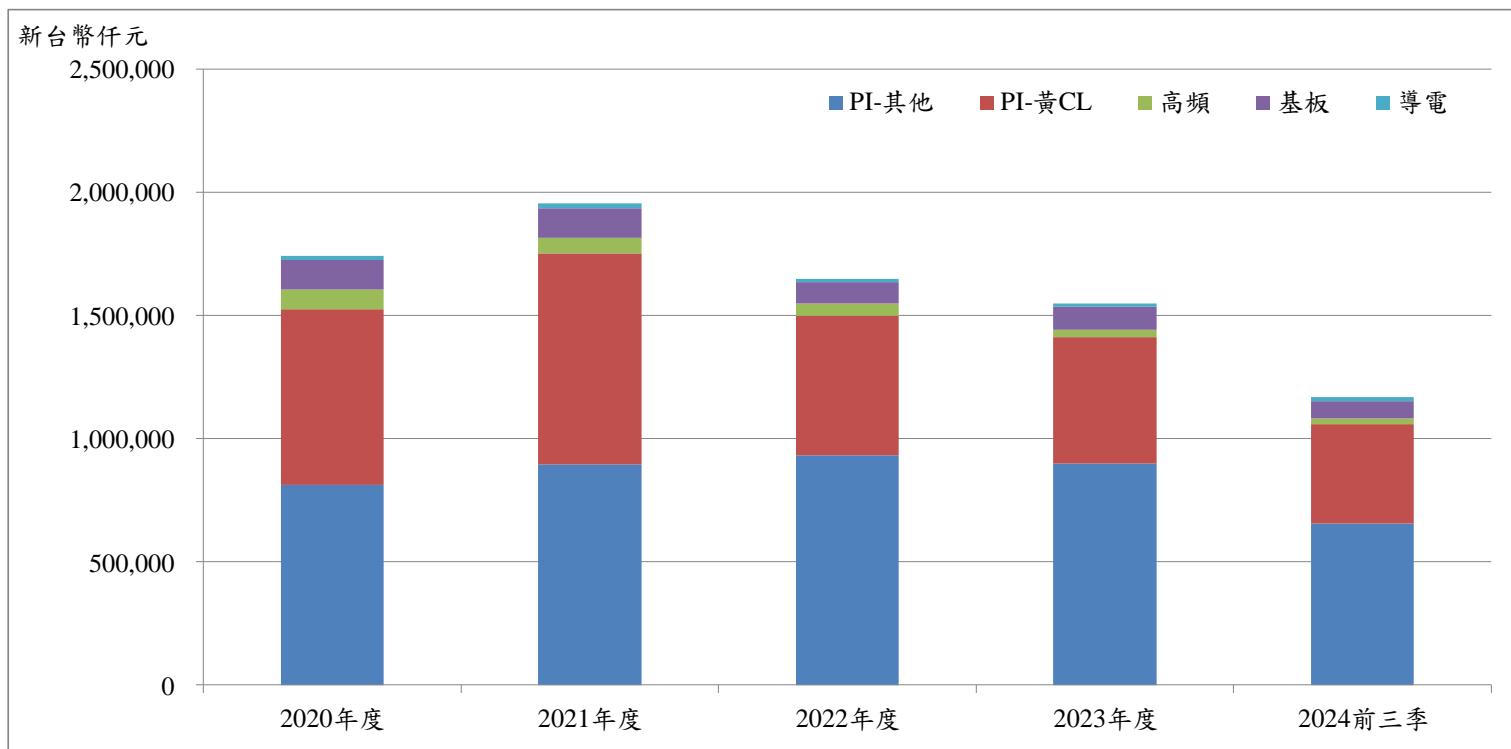
財務報告(Financial Results)

合併損益表

單位：新台幣仟元

年度	2024/Q3	2024/Q2	2024/Q1	2023/Q4	2023/Q3	QoQ	YoY
營業收入	409,745	400,737	356,955	421,571	447,110	2.25%	-8.36%
營業成本	318,306	309,206	275,245	338,172	342,318	2.94%	-7.01%
營業毛利	91,439	91,531	81,710	83,399	104,792	-0.10%	-12.74%
毛利率	22.32%	22.84%	22.89%	19.78%	23.44%		
營業費用	74,474	79,299	68,318	65,137	74,413	-6.08%	0.08%
營業淨利	16,965	12,232	13,392	18,262	30,379	38.69%	-44.16%
稅前淨利	17,786	9,153	18,842	4,359	39,672	94.32%	-55.17%
稅後淨利	11,145	4,226	13,067	2,826	29,580	163.72%	-62.32%
淨利率	2.72%	1.05%	3.66%	0.67%	6.62%	157.93%	-58.89%
EPS	0.11	0.04	0.13	0.03	0.30	163.72%	-62.32%

營收結構



註：PI-其他包含黑色覆蓋膜、補強版及複合膜等

合併資產負債表

單位：新台幣仟元

	2024/9/30		2024/6/30		2023/12/31		2023/9/30	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	391,711	14.13%	480,839	16.79%	448,996	16.98%	398,260	14.37%
應收票據及帳款(含關係人)	867,512	31.30%	852,236	29.76%	826,752	31.27%	888,974	32.07%
存貨	315,071	11.37%	322,351	11.26%	206,691	7.82%	369,614	13.34%
流動資產	1,630,323	58.82%	1,698,162	59.30%	1,530,615	57.89%	1,710,283	61.71%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	149,045	5.38%	151,834	5.30%	145,727	5.51%	149,039	5.38%
不動產、廠房及設備	814,137	29.37%	833,824	29.12%	795,144	30.08%	834,533	30.11%
資產總計	2,771,691	100.00%	2,863,548	100.00%	2,643,779	100.00%	2,862,100	103.26%
短期借款	573,969	20.71%	574,928	20.08%	533,067	20.16%	589,307	21.26%
應付票據及帳款	217,585	7.85%	251,445	8.78%	146,082	5.53%	272,539	9.83%
流動負債	944,945	34.09%	1,029,486	35.95%	753,857	28.51%	920,878	33.22%
負債合計	1,222,079	44.09%	1,311,177	45.79%	1,125,604	42.58%	1,298,660	46.85%
股本	982,009	35.43%	982,009	34.29%	982,009	37.14%	982,009	35.43%
股東權益合計	1,549,612	55.91%	1,552,371	54.21%	1,518,175	57.42%	1,563,440	56.41%
負債及權益總計	2,771,691	100.00%	2,863,548	100.00%	2,643,779	100.00%	2,862,100	103.26%

現金流量表

單位：新台幣仟元

	2024/Q1-Q3	2023/Q1-Q3
折舊及攤銷	52,655	48,533
應收款項減少(增加)	(53,136)	(193,699)
存貨減少(增加)	(108,380)	(125,962)
應付款項增加(減少)	71,503	145,221
營業活動之淨現金流入(流出)	(27,598)	(108,208)
取得不動產、廠房及設備	(44,634)	(49,122)
投資活動之淨現金流入(流出)	(44,664)	(34,980)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(11,050)	(209,215)
期末現金總額	391,711	398,260

未来展望(Future Outlook)

手機市場

- 2025年電子行情延續的關鍵在於AI關聯多方位應用，半導體封裝的創新技術及成長。

車載應用

- 除電動車外，儲能設備在軟板應用需求逐漸增加，亦是明年車載主力，持續布局相關產品。

生產策略

- 生產流程持續優化，目標朝向自動化智能工廠，提升人均產值。

新產品

- 積極布局耐離子遷移CL、EMI、導電膠、Low loss高頻產品、車載儲能應用、多層板用壓克力膠、透明材料及自製無膠雙面板。

~簡報結束Thank you~

更多資訊請詳見公司官網：<http://www.aemg.com.tw>